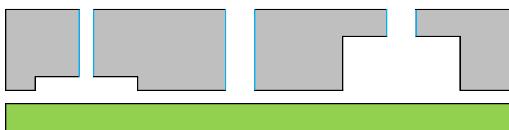
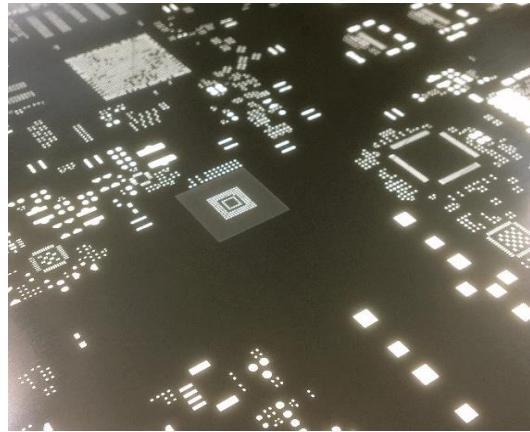
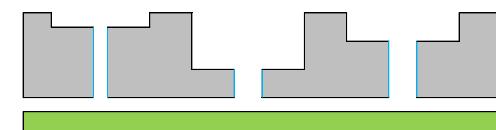
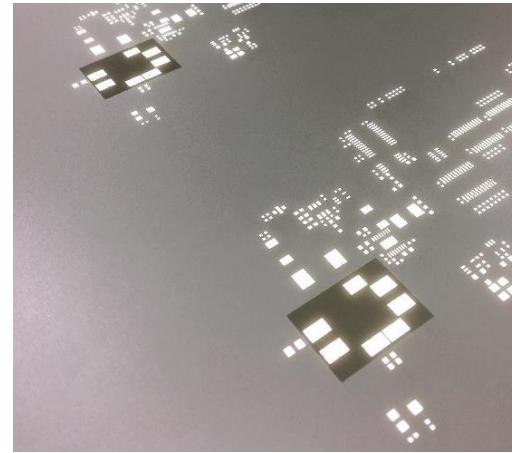


混載部品搭載に最適、  
部分的に板厚を増減することにより、はんだ量の調整が可能



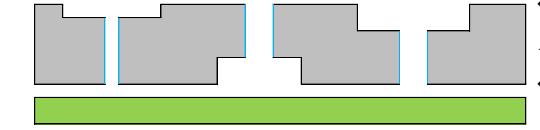
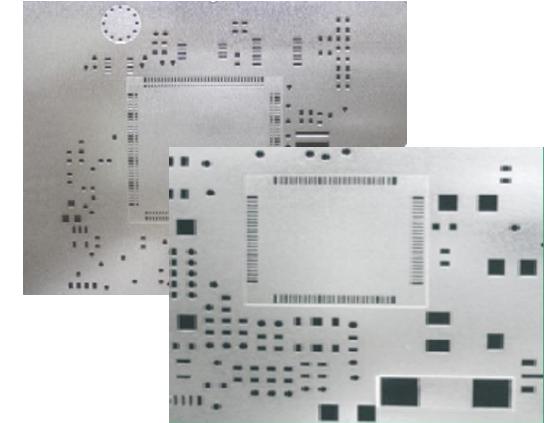
基板面側ハーフ

スキージを気にせず印刷



スキージ面側ハーフ

基板の滲みを気にせず印刷



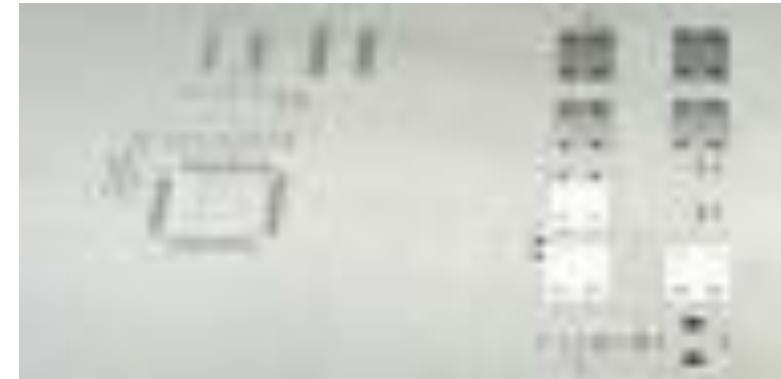
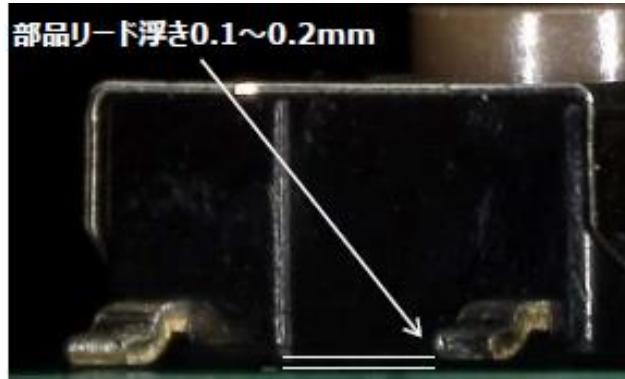
両面ハーフ

大型部品ははんだを多く  
小型部品ははんだを少なく  
バランス良く印刷

スイッチのリード高さにバラツキが…高確率で未はんだがでてしまう

⇒ アイランドハーフメタルマスクをご提案

※スイッチ部メタル厚 + 30  $\mu$ m(基板接触面側)



## ◆結果

ご提案前

7シート中7シート全てで未はんだ発生

アイランドハーフ処理  
ご提案後

7シート全てで不良率がゼロに。他部品への影響なし。



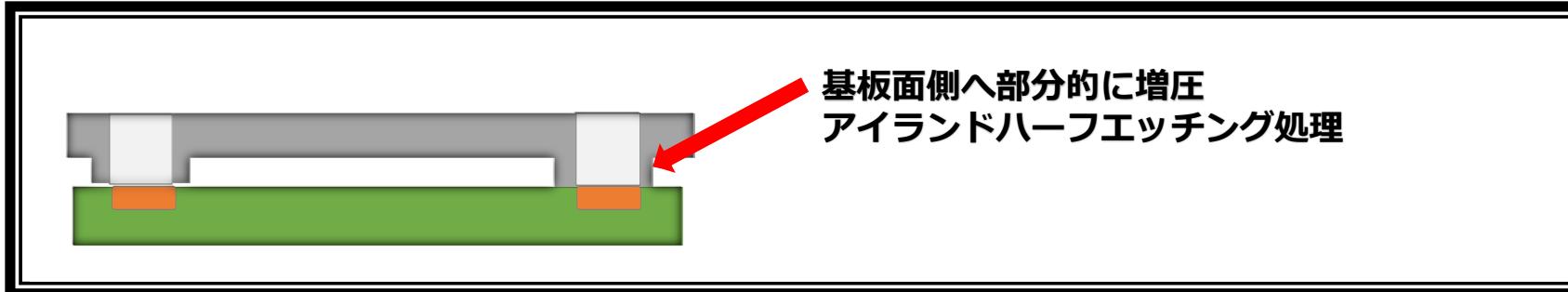
リードからの  
フィレット形成が確認できた。

## 事例：部品のリード浮き不良

### 問題



### 処理



### 改善

